

檔 號：
保存年限：

財團法人中華民國對外貿易發展協會 函

地址：11012臺北市基隆路1段333號6樓
傳真：02-2757-6653
承辦人：服務業推廣中心 劉欣宜
電子郵件：hsinyi@taitra.org.tw
聯絡電話：02-2725-5200 分機：1966

受文者：台北市進出口商業同業公會

發文日期：中華民國107年5月21日
發文字號：外廣字第1073801064號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：

附件：「2018年臺灣赴日攬才團報名表及職缺表」、「2018年臺灣赴日攬才團DM」(107D005720_107D2005095-01.pdf、107D005720_107D2005096-01.doc)

主旨：為協助國內企業、研究機構及法人延攬海外專業人才，經濟部投資業務處委由本會於本(107)年7月2日至6日籌組「2018年臺灣赴日攬才團」，赴日本延攬優秀人才，邀請貴單位參團，並請轉知會員廠商踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、經濟部自92年起每年邀請國內有意延攬海外人才之產、官、學、研等單位，赴美、加、日及印度等人才群聚城市辦理攬才媒合會，106年臺灣赴日攬才團共計31家國內知名企業報名參團，並吸引337位人才到場求職、舉行675人次洽談，成效良好。
- 二、本攬才團預定於本年7月2日至6日參訪日本東京及大阪兩城市，舉辦1場臺灣企業攬才說明會(東京)及1場企業與人才一對一媒合會(大阪)。為擴大活動成效，另規劃參訪知名學府之活動。
- 三、本攬才團之特色與效益如下：
 - (一)攬才重點產業除半導體、資通訊、光電、機械、生技醫



材及綠能等製造業外，並涵蓋金融產業等重點服務業。

(二)直接與人才接觸：現場可直接接觸國際間各領域的優秀人才，有效縮短延攬人才的時間，有助提升我國企業及研發機構之國際競爭優勢。

(三)降低海外攬才成本：本團係整合政府跨部會資源，動員政府駐外單位力量，並藉助當地科技團體及僑界的人脈及媒體擴大宣傳，團員僅須負擔出差人員機票及新幹線之交通費及住宿費，有關當地交通費及人才媒合會之場地費等，均由該委辦計畫支應，有效降低企業或法人海外攬才的成本。

四、檢附旨揭活動DM、報名表及職缺表，請踴躍報名參團，並轉知會員廠商踴躍報名參加。

正本：財團法人工業技術研究院、台灣半導體產業協會、台日產業合作推動辦公室、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、社團法人中華民國工業協進會、社團法人中華民國全國中小企業總會、財團法人光電科技工業協進會、中華民國資訊軟體協會、中華民國台灣區電子遊戲機協會、財團法人台灣食品產業策進會、財團法人食品工業發展研究所、財團法人資訊工業策進會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、台灣區不織布工業同業公會、台灣區光學工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣區食品暨製藥機械工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區醫療暨生技器材工業同業公會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國觀光旅館商業公會、台北市電腦商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、財團法人車輛研究測試中心、財團法人生物技術開發中心、財團法人醫藥工業技術發展中心、財團法人精密機械研究發展中心、財團法人塑膠工業技術發展中心、財團法人紡織產業綜合研究所、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、財團法人中華民國紡織業拓展會、中華民國餐飲食業工會全國聯合會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國產物保險商業同業公會、台灣國際物流暨供應鏈協會、台灣區照明燈具輸出同業公會、社團法人國家生技醫療產業策進會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會、台北市旅行商業同業公會、台北市百貨商業同業公會、臺灣製藥工業同業公會、台北市汽車代理商商業同業公會、財團法人金屬工業研究發展中心、社團法人中華民國工商協進會、財團法人生技醫療科技政策研究中心

副本：2018-05-23
交 09:07:43

財團法人中華民國對外貿易發展協會